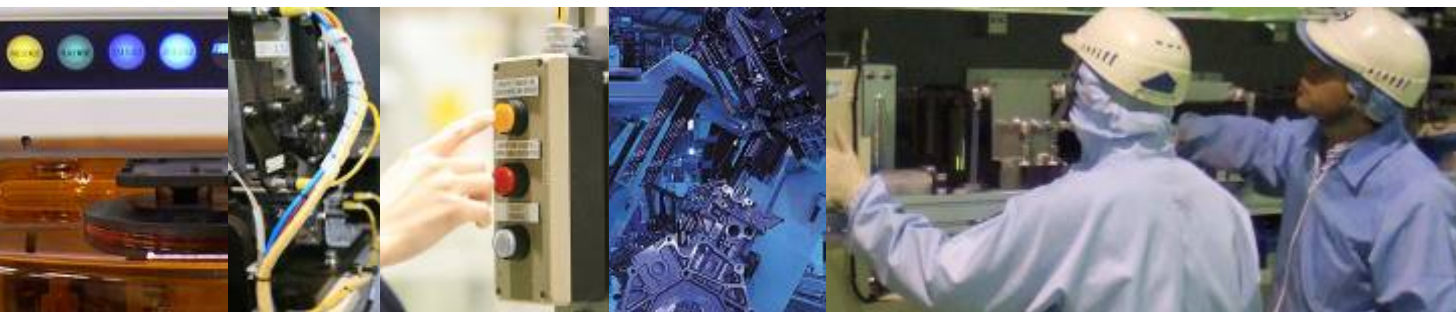


2008年3月期 中間決算説明会

平田機工株式会社 2007.11.19

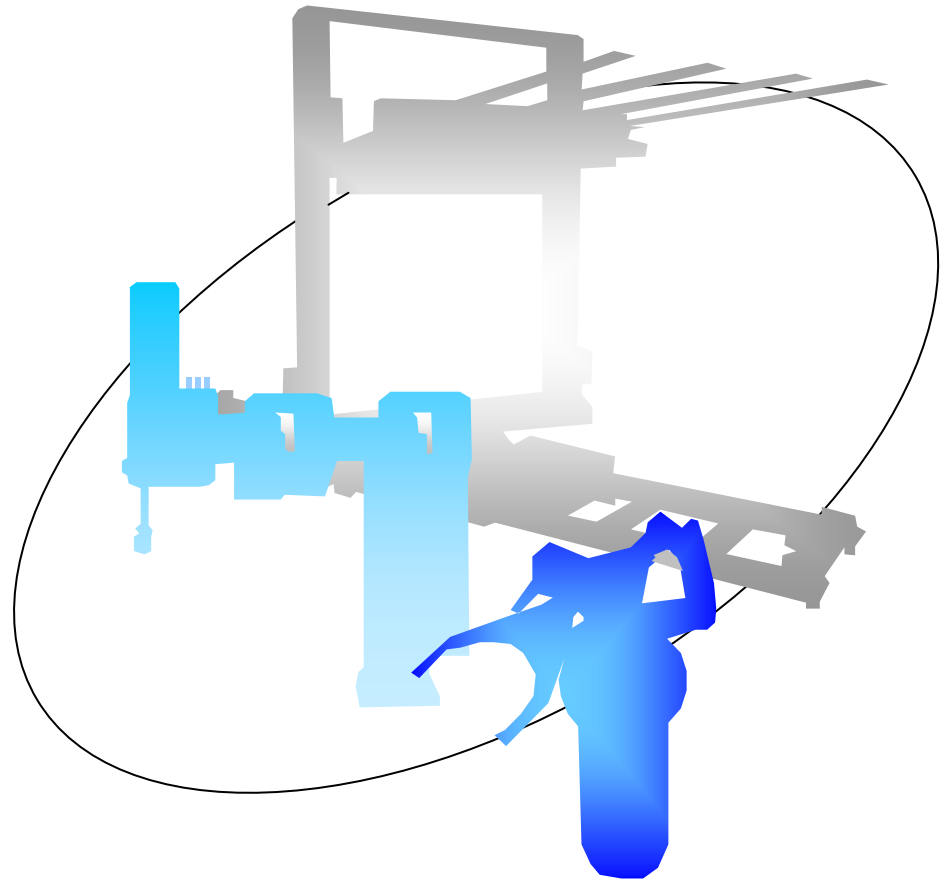


The Global Production Engineering Company
Hirata

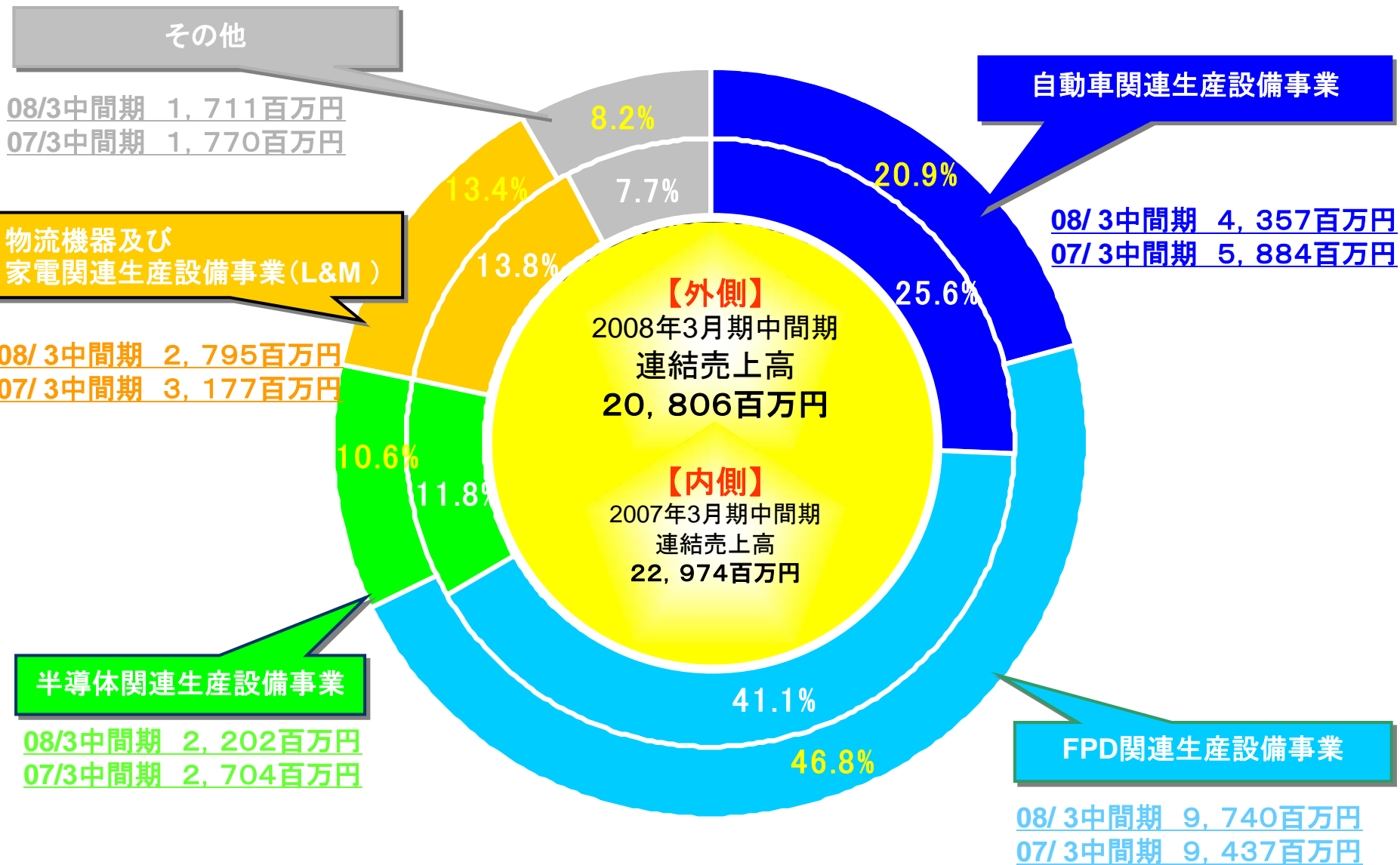


I 中間期決算状況

2008年3月期 中間期（2007年9月30日）



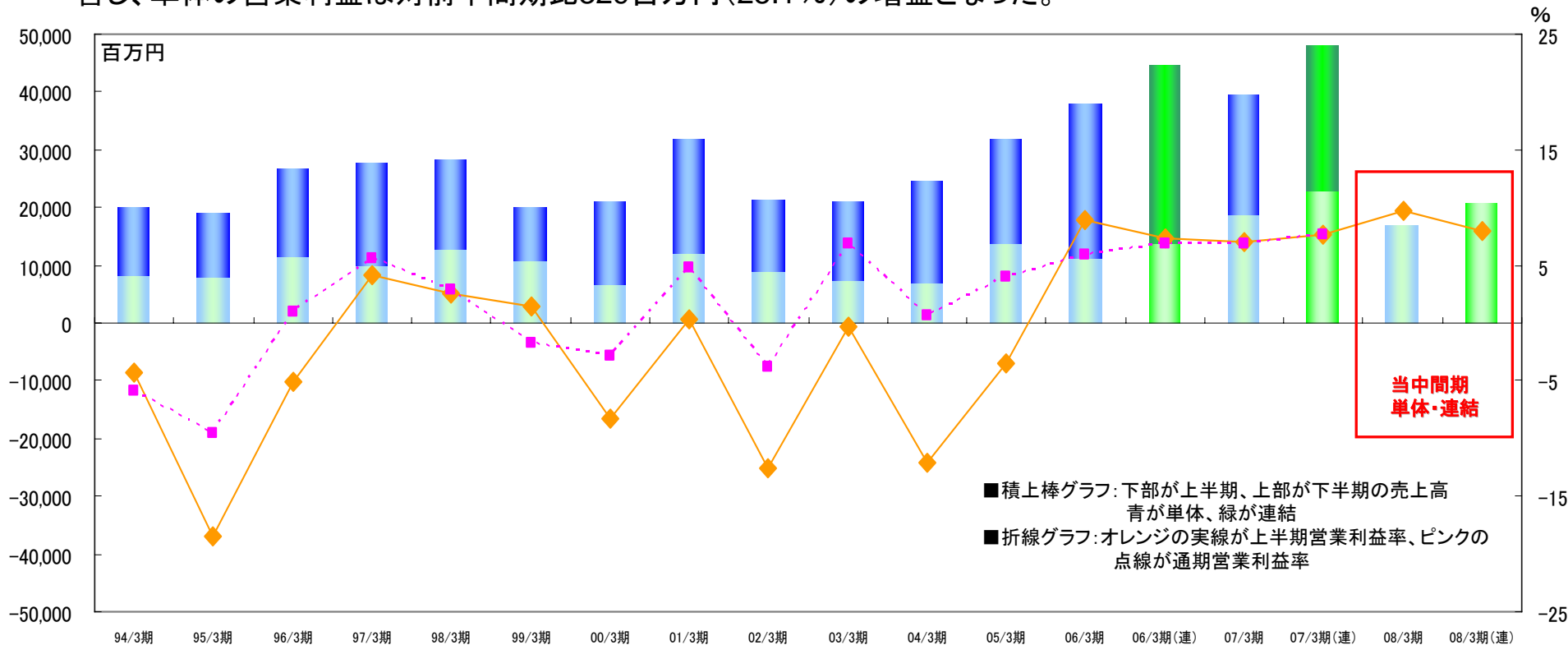
I 中間期決算状況 事業部門別売上高構成比



I 中間期決算状況

2008年3月期中間期の実績

- ◆ 売上高では、単体・連結ともに過去最高であった前中間期の実績には達しなかったものの、営業利益率では、単体で対前中間期比2.7ポイント増の9.7%、連結で0.4ポイント増の8.0%と、中間期としては過去最高となった。
- ◆ 連結売上高は、自動車関連生産設備事業の減少等により対前中間期比9.4%の減少となった。原価率の低減により、売上総利益は対前中間期比8.8%増加したが、研究開発費、J-SOX関連費用等の増加に伴い販管費が対前中間期比17.9%の増加となった。この結果、営業利益の絶対額は対前中間期比71百万円の減少となったが、営業利益率では、単体で対前中間期比2.7ポイント増の9.7%、連結で0.4ポイント増の8.0%と改善し、単体の営業利益は対前中間期比329百万円(25.1%)の増益となった。



I 中間期連結決算状況 事業部門別実績 連結売上高

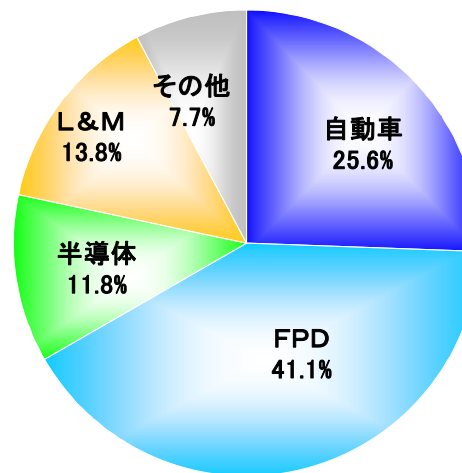
- ・ FPD関連設備は、アジア向けが不振であったものの、国内向けが好調で増収(+3.2%)
- ・ 自動車関連設備は、北米向け他の低調で減収(▲26.0%)
- ・ L&M関連設備はFPDのモジュール・液晶テレビセット向け設備が増加したものの、IT関連向け設備等が低調で減収(▲12.0%)

事業部門別売上高の状況

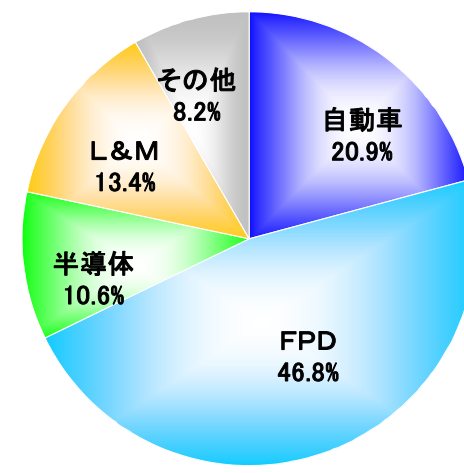
単位:百万円

事業部門	2007/3 中間期	2008/3 中間期	前年同期比
自動車	5,884	4,357	▲26.0%
FPD	9,437	9,740	3.2%
半導体	2,704	2,202	▲18.6%
L&M	3,177	2,795	▲12.0%
その他	1,770	1,711	▲3.3%
合計	22,974	20,806	▲9.4%

2007/3 中間期



2008/3 中間期



I 中間期連結決算状況 地域別連結売上高

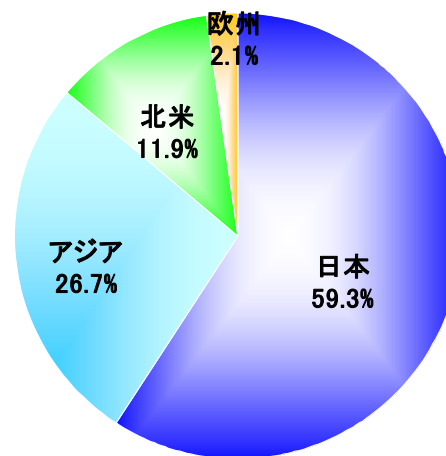
- ・ アジア地域向けは、FPD関連設備投資の先送りで激減(▲85.9%)
- ・ 欧州向けは、L&M関連設備のうち、薄型テレビのモジュール・セット設備の増加で大幅増(+230.7%)
- ・ 国内向けは、FPD関連設備などが堅調で、増加(+10.4%)

地域別売上高の状況

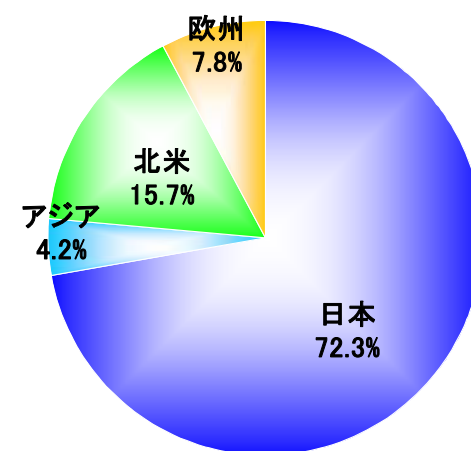
単位:百万円

地域	2007/3 中間期	2008/3 中間期	前年同期比
日本	13,617	15,036	10.4%
アジア	6,136	866	▲85.9%
北米	2,724	3,266	19.9%
欧州	494	1,636	230.7%
その他	—	—	—
合計	22,974	20,806	▲9.4%

2007/3 中間期



2008/3 中間期



I 中間期連結決算状況 事業部門別実績 連結受注高

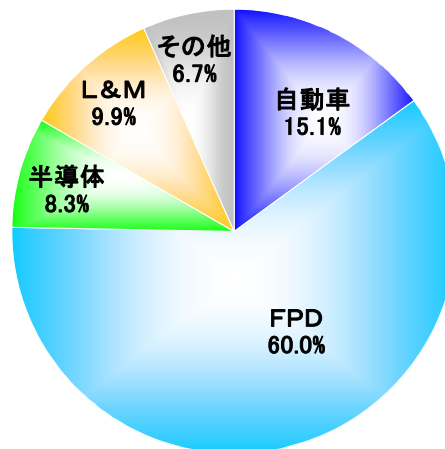
- FPD関連設備以外は好調を維持
 自動車関連設備は、クライスラー社向け新エンジン組立ラインの受注で大幅増(+137.9%)
 半導体関連設備は、ロードポート、ロボット等の製品が徐々に装置メーカーに認められつつあり、確実に増加(+12.9%)
 L&M関連設備は、内外タイヤメーカーからの新規受注が拡大(+86.3%)
- FPD関連設備は、前期G8を中心とする大型設備受注で増加した反動とアジア、中国メーカーの投資延期で大幅減(▲74.3%)

事業部門別受注高の状況

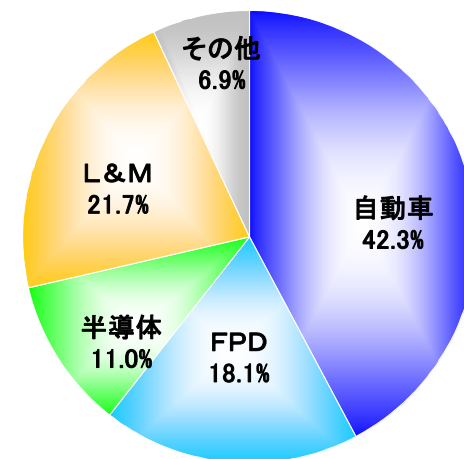
単位:百万円

事業部門	2007/3 中間期	2008/3 中間期	前年同期比
自動車	4,208	10,013	137.9%
FPD	16,690	4,296	▲74.3%
半導体	2,303	2,600	12.9%
L&M	2,753	5,130	86.3%
その他	1,849	1,645	▲11.0%
合計	27,805	23,686	▲14.8%

2007/3 中間期

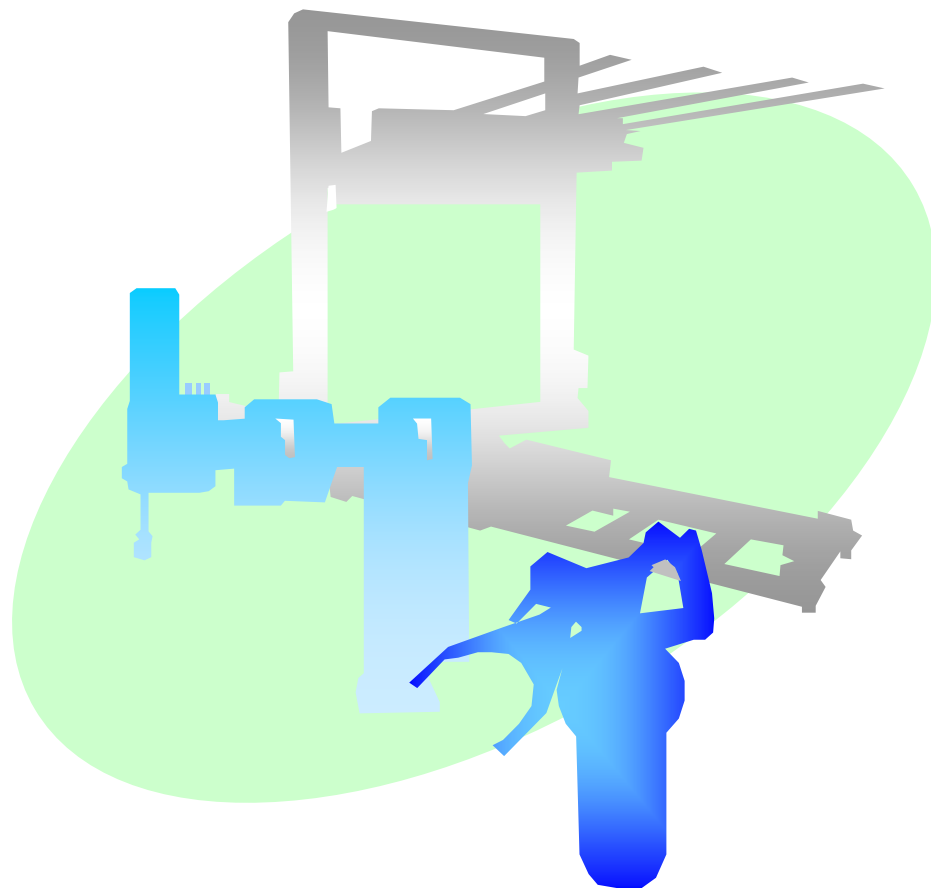


2008/3 中間期



Ⅱ 今期業績の見通し

2008年3月期 中間期（2007年9月30日）



◆自動車関連事業

- 完成車
国内は完成車販売台数が落ちるも欧州・アジア向けに輸出は好調。
アメリカ国内の完成車販売台数は減少傾向だが、北米完成車メーカーの投資意欲は低下していない。
- 部品
ハイブリッド車、ディーゼルエンジン向けコア部品などの環境関連設備が好調。

◆FPD関連事業

2007年は設備投資の谷間の年になるが、国内ではG10関連が具体化。
台湾もTFTパネルの需給が引き締まり、投資意欲が回復。
中国もG5、G6を中心に、投資が活発化。

◆半導体関連事業

DRAMは価格下落で投資動向は不透明ながら、微細化投資は継続。

◆L&M関連事業

国内外のタイヤメーカーの投資は持続。

Ⅱ 今期業績の見通し 連結業績予想

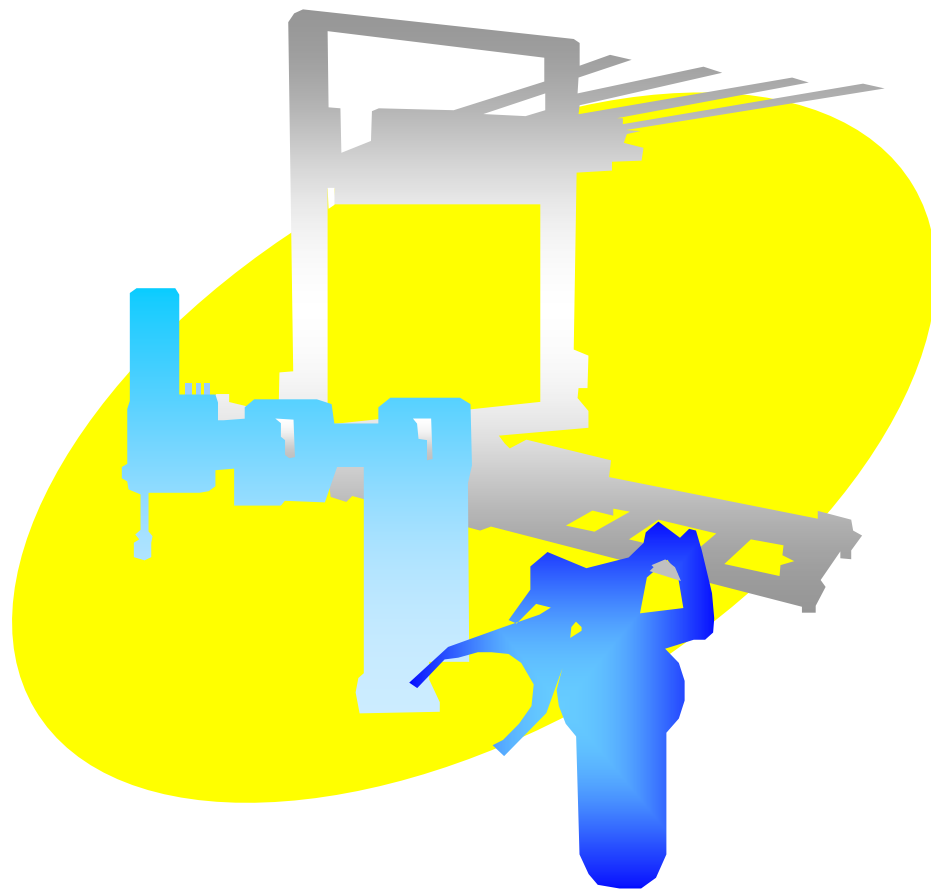
- ◆ 売上高は、自動車関連事業とFPD関連事業が前期・前々期の史上最高売上に及ばず減収となるが、半導体、L&M等で補って増収を計画
- ◆ 営業利益は、社内加工生産量の拡大による外注費の削減、品質向上活動による追加・無償工事費用の圧縮等により、増益確保を目指す

(単位: 億円、%)

	2007年3月期	2008年3月期			
		上期(実績)	下期(見通し)	通期(見通し)	対前期増減
売上高	481	208	292	500	+3.8%
自動車関連	130	43	84	128	▲2.6%
FPD関連	183	97	80	177	▲3.4%
半導体関連	57	22	42	64	+11.5%
L&M関連	76	27	62	90	+18.3%
その他	34	17	24	41	+19.6%
営業利益(率)	37(7.7%)	16(8.0%)	21(7.3%)	38(7.6%)	+2.5%
経常利益(率)	34(7.1%)	15(7.6%)	20(6.9%)	36(7.2%)	+5.2%
当期純利益(率)	18(3.9%)	6(3.1%)	13(4.6%)	20(4.0%)	+7.0%

Ⅲ 中期経営計画

2008年3月期 中間期（2007年9月30日）



自動車・FPD・半導体分野における生産エンジニアリングの リーディングカンパニーへ

2007年 — 2009年
中期経営計画

持続的な成長を可能にする基礎づくり

中長期発展の基礎確立の為、組織的な経営体制の整備・強化

生産エンジニアリングとモノ造りを両輪としたグローバル企業

持続可能な競争力と安定的な業容・収益

■ 1・2・3・4計画の現状と見通し(単体ベース)

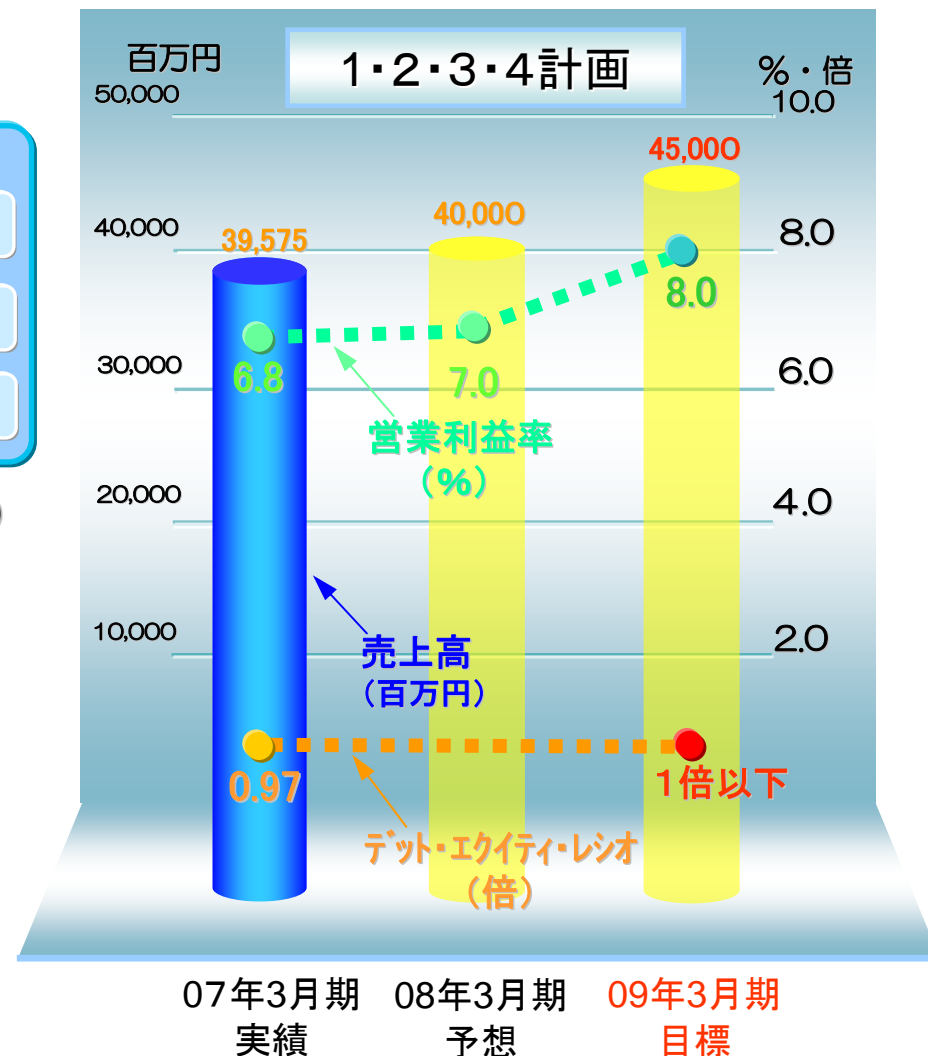
● 09年3月期に当社単体で以下の目標を達成する。

1: 有利子負債比率(デット・エクイティ・レシオ) **1**以下
当中間期実績は1.0倍。堅調に推移している。

2: 営業利益率 **2**倍(対05年3月期4.0%比)
当中間期実績は9.7%。堅調に推移している。

3: リードタイム **30**%以上削減
LT30プロジェクトによる削減活動を展開中。

4: 売上高 **450**億円以上
当期計画を達成すると共に更なる受注拡大を図る。

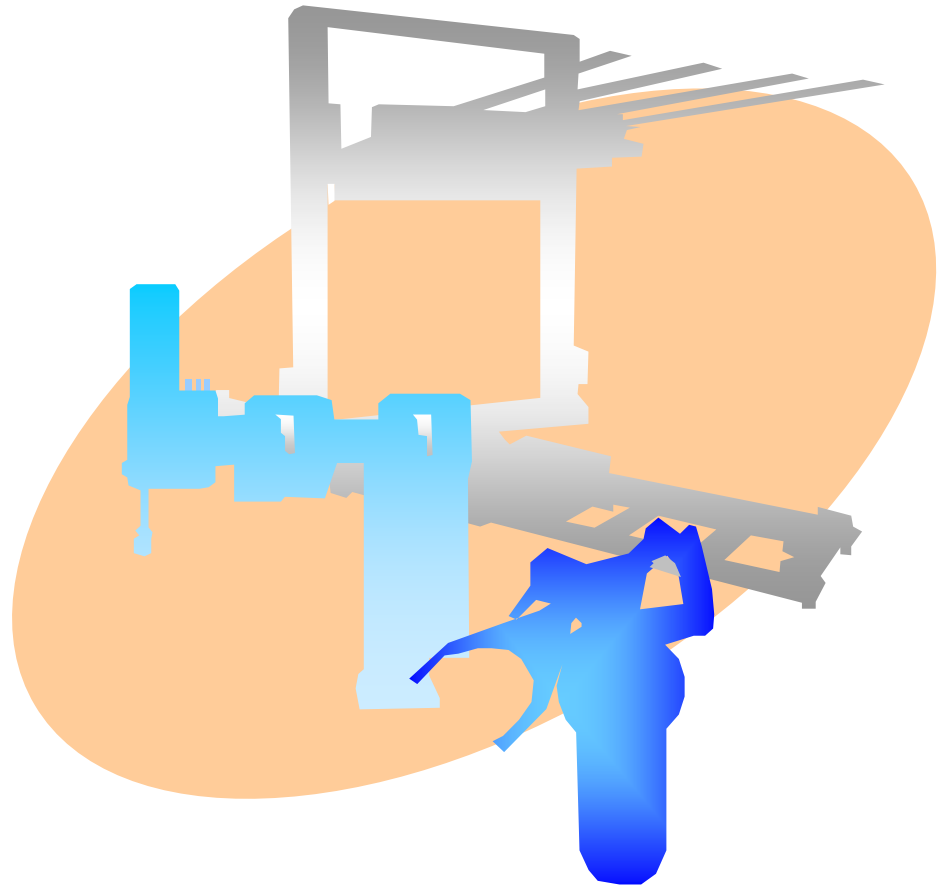


持続的な成長を可能にする基礎づくり

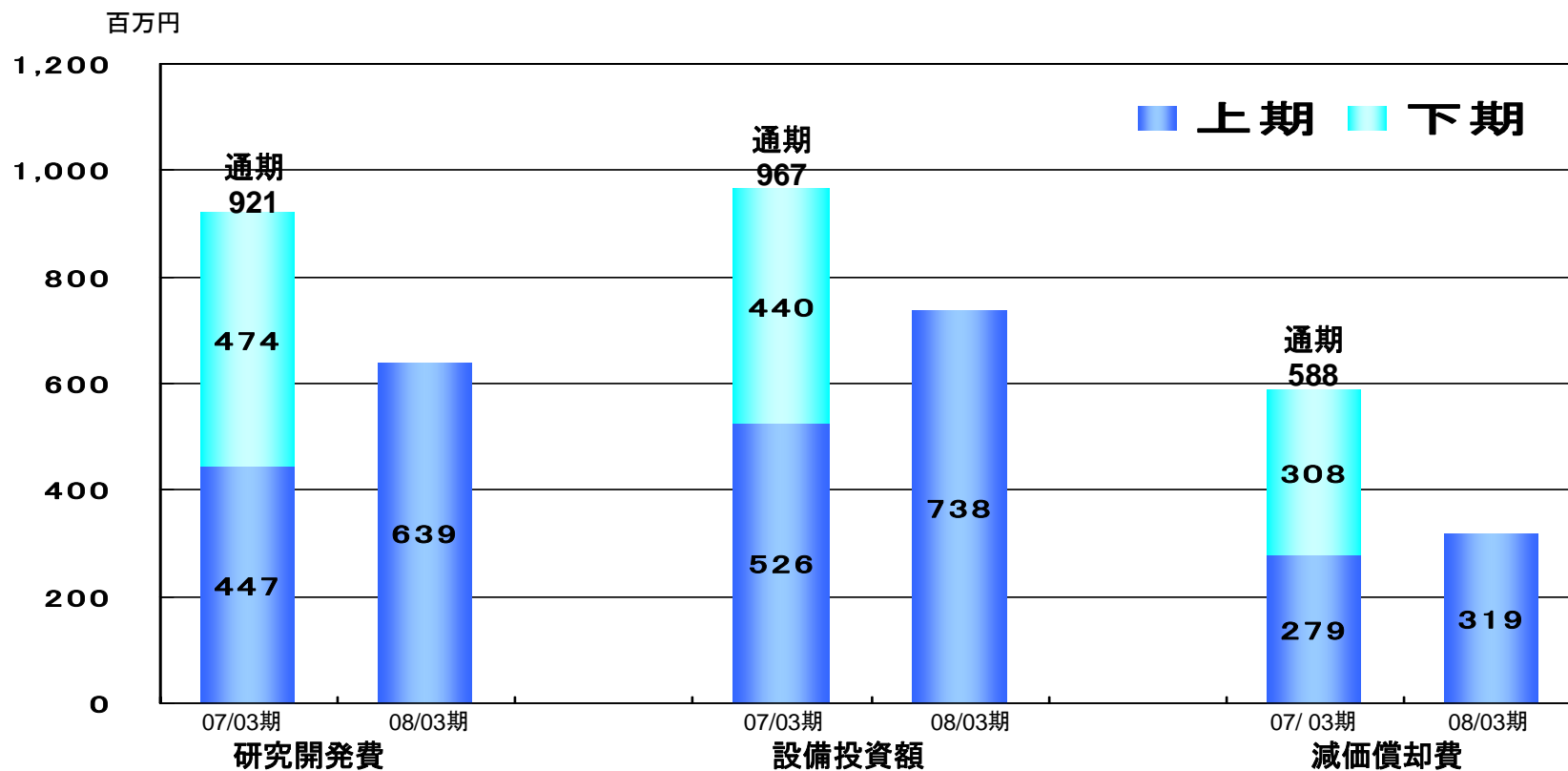
	平 田 機 工	子 会 社
今期の 主な 施策 ・ トピ ックス	<p>■ 事業別ビジネスユニット制の確立</p> <p>※事業部門ビジネスユニット設置による各事業領域の強化</p>	<p>■ HCT（台湾現地法人）の本格稼働</p> <p>※台湾市場の戦略拠点確保</p>
	<p>■ 基礎技術部の設置</p> <p>※次期製品拡充のための要素技術研究強化</p>	<p>■ HAS（中国現地法人）工場の建設</p> <p>※中国市場の拠点再編・事業拡大</p>
	<p>■ 第10世代液晶パネル用ガラス基板搬送ロボットの開発</p> <p>※液晶事業の競争力強化</p>	<p>■ ヒラFAEの稼働</p> <p>※メンテナンス・サービス事業の強化</p>
	<p>■ 米国BLUESHIFT社との業務提携</p> <p>※半導体市場における競争力の強化</p>	<p>■ IIJ社との資本提携</p> <p>※子会社タイハイコンピュータの事業拡大</p>
	<p>■ 収益体質改善</p> <p>※LT30プロジェクト、社内加工生産量拡大活動</p>	<p>■ 太平興産、タイハイコンピュータの代表取締役異動</p> <p>※グループ経営基盤の強化</p>
	<p>■ 米クライスラー社からの大型エンジン組立ラインの受注確保</p> <p>※70億円規模の受注により今期及び来期の業績に寄与</p>	<p>■ 太平興産新社屋建設</p> <p>※機電販売事業拡大のためのインフラ整備</p>

IV 参考資料

2008年3月期 中間期 (2007年9月30日)



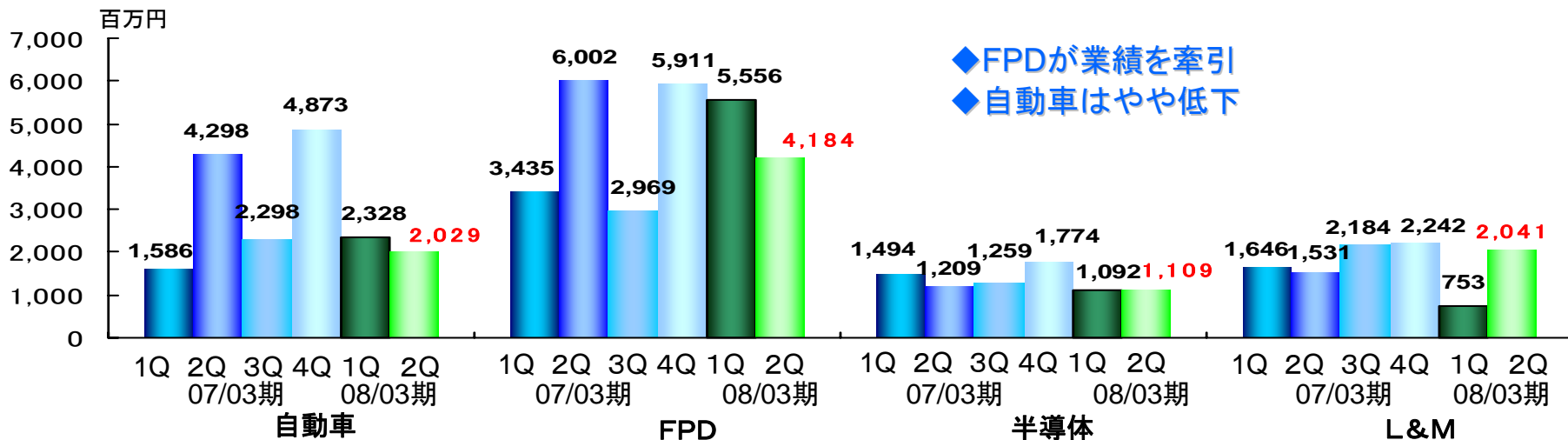
IV 参考資料 研究開発費・設備投資額・減価償却費



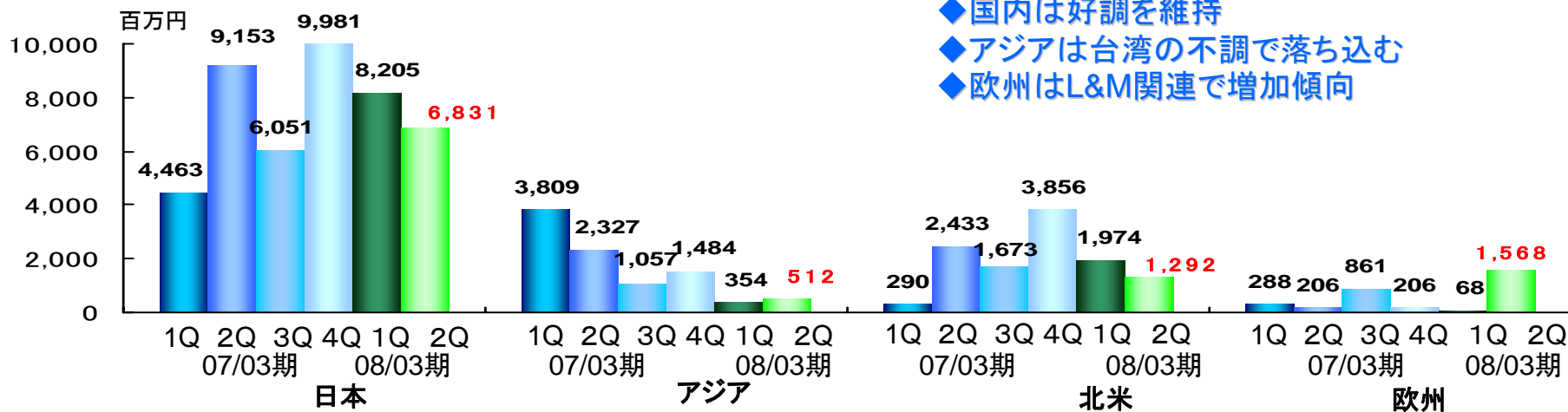
- 研究開発費：第10世代液晶基板搬送ロボット及びローダーの開発等により、前年同期比42.8%増の639百万円を計上。
- 設備投資額：中国新工場建設の他、当社の加工機械購入などにより、前年同期比42.8%増の738百万円を計上。
- 減価償却費：前年同期比14.3%増の319百万円を計上。

IV 参考資料 事業部門別・地域別四半期推移(売上高)

事業部門別四半期売上高の推移

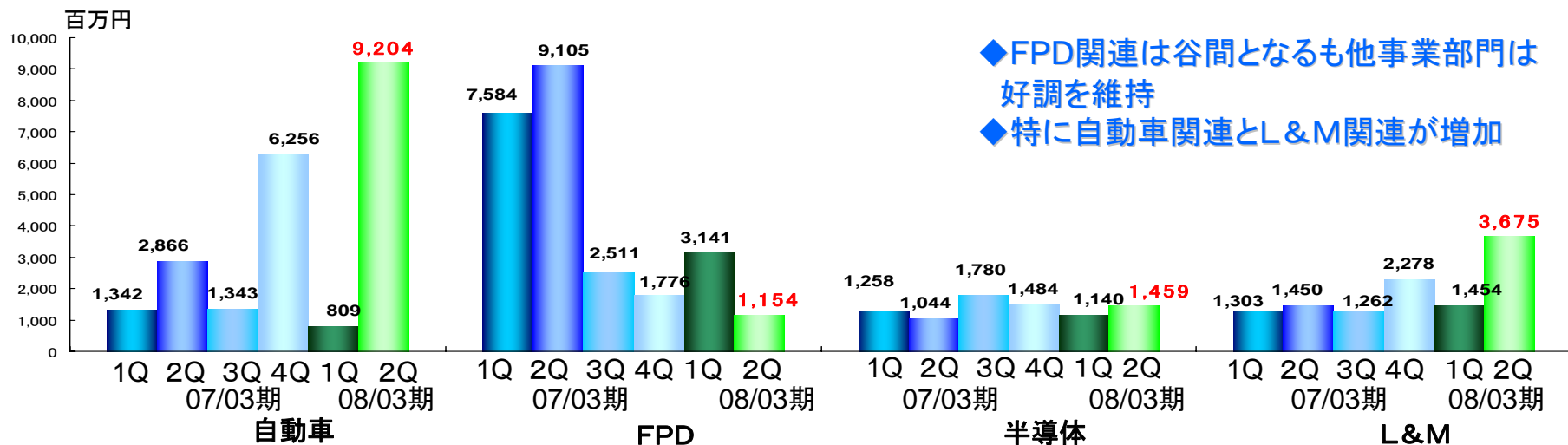


地域別四半期売上高の推移

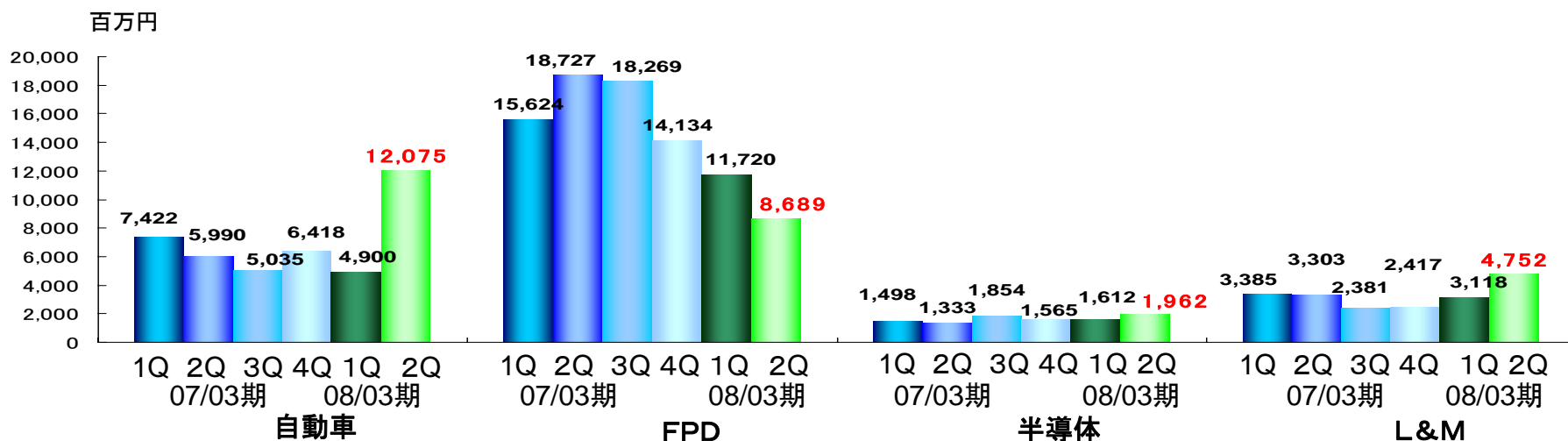


IV 参考資料 事業部門別四半期推移(受注高・受注残高)

事業部門別四半期受注高の推移

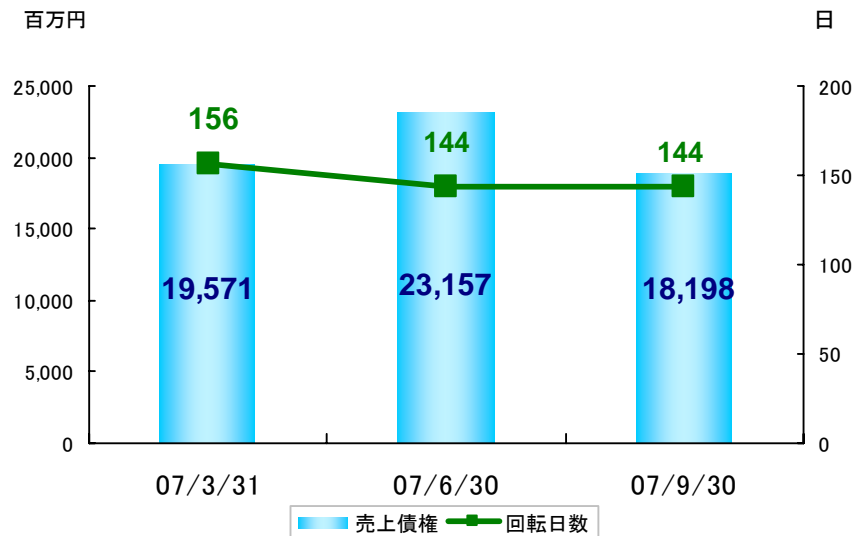


事業部門別四半期受注残高の推移

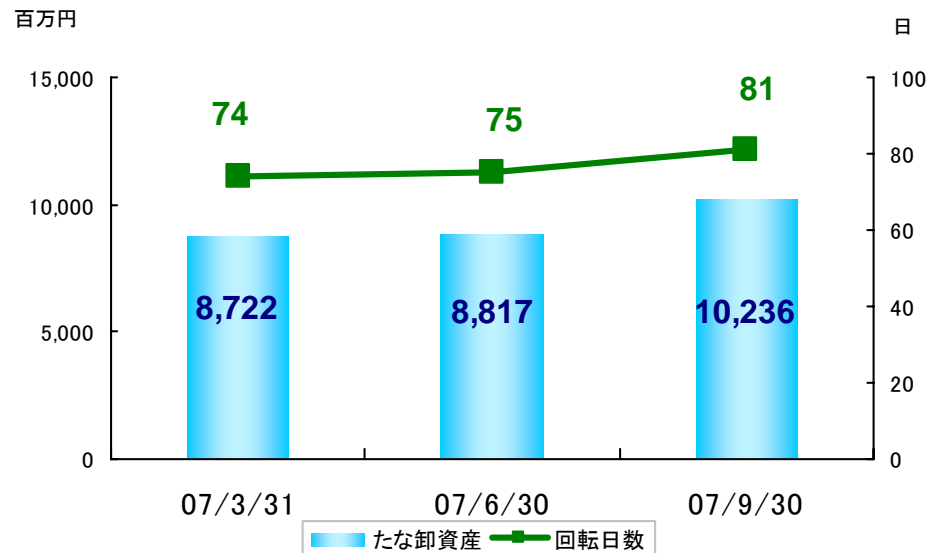


IV 参考資料 主要指標

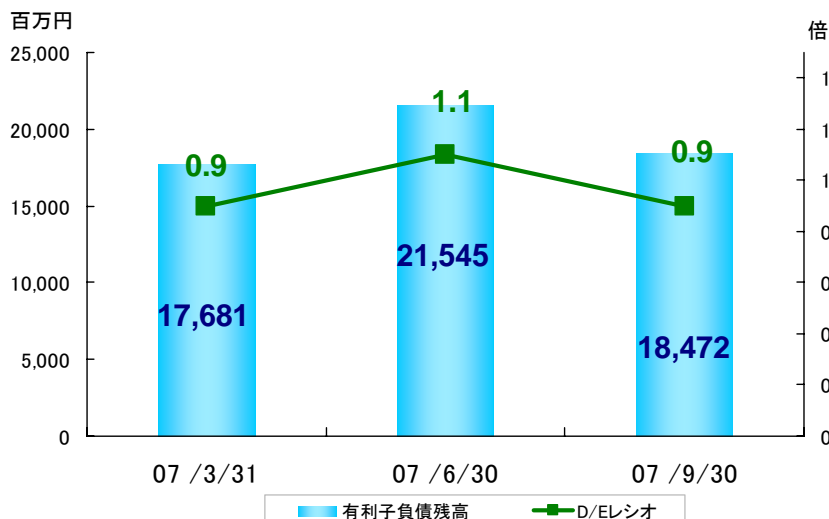
売上債権・売上債権回転日数



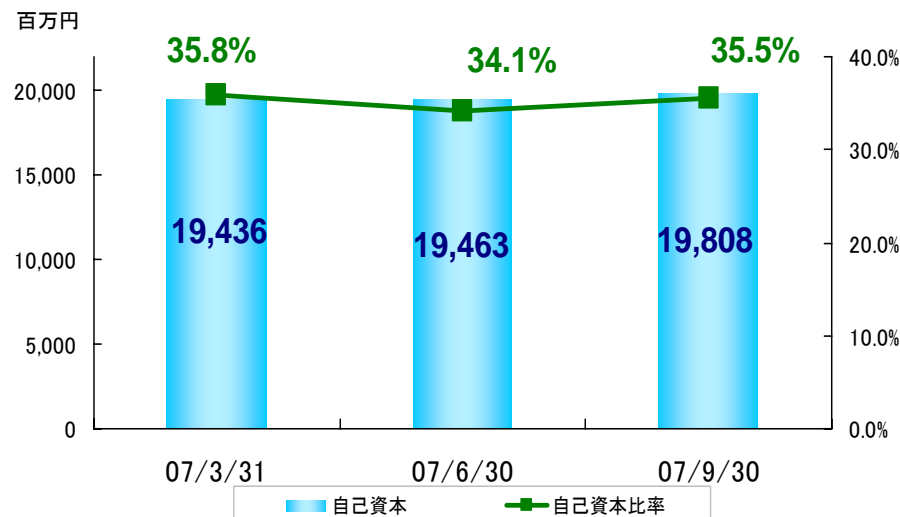
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。